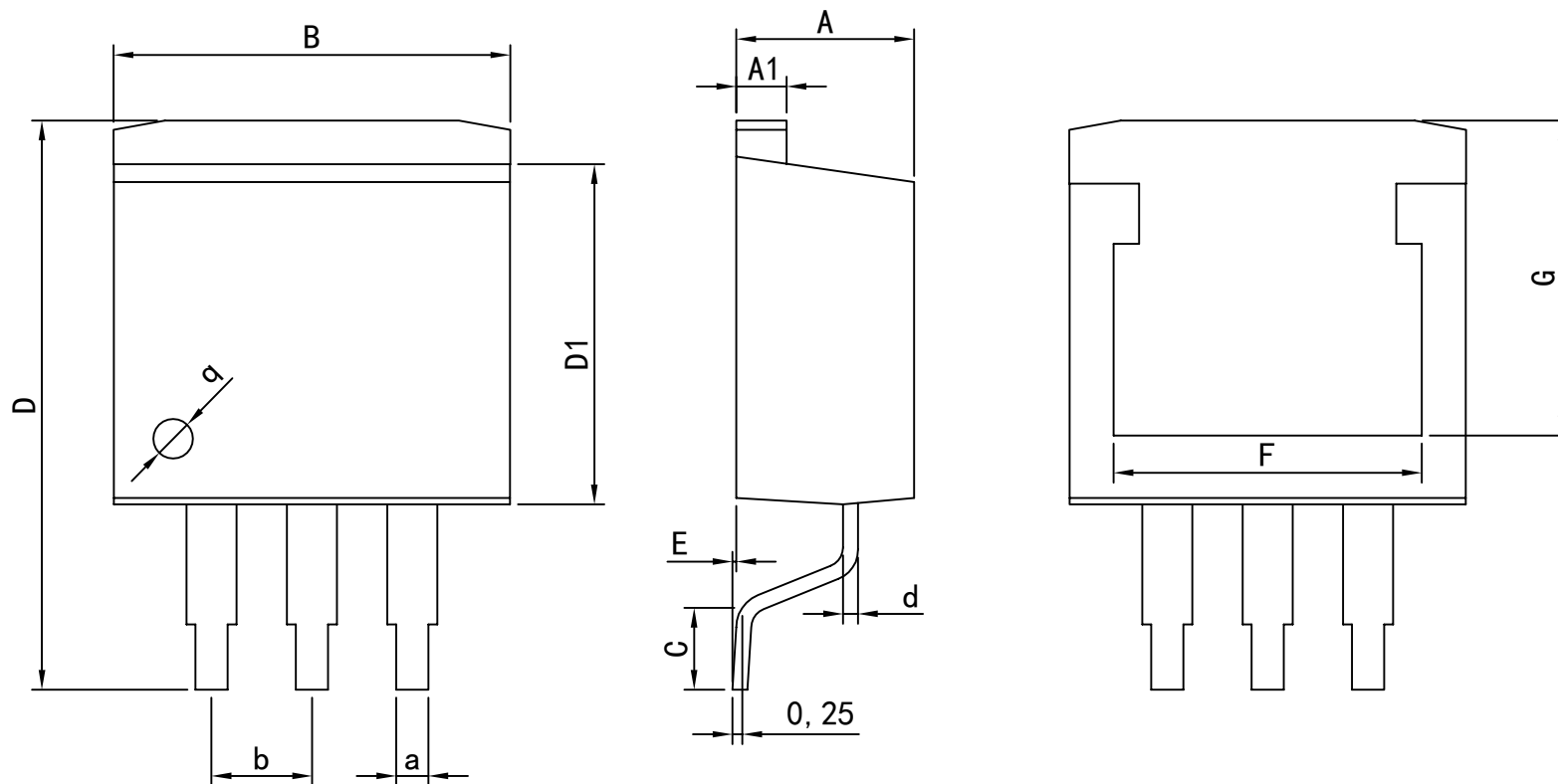




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

T0263-3

文件名称:
HG-T0263-3

文件编号:
HGWT-230020

版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-28

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	D	D1	E	F	G	a	b	
MIN	4.45	1.22	10.0	1.89	13.7	8.38	0.00	8.332	7.70	0.71	2.54	
MAX	4.62	1.32	10.4	2.19	14.6	8.89	0.305	8.552	8.10	0.97	BSC	